



第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

演讲题目: 高密度玻璃基封装基板

演讲人: 崔成强 教授、董事长 广东工业大学、广东佛智芯微电子技术研究有限公司

演讲摘要:

随着 AI 算力等应用场景需求逐渐提高,玻璃基板凭借其天然的电气特性、优异的机械性能、良好的热导率和较低的热膨胀系数,成为新型先进封装技术基板的研究重点,其核心技术 TGV 也作为下一代先进封装工艺。崔教授长期从事封装基板的研究及产业化。在最近 4 年多的玻璃基板研发和生产工作,目前已掌握玻璃微孔加工技术,实现孔型、孔径、锥度可控加工;在玻璃表面金属化方面,实现低温、低粗糙度、高结合力玻璃基板制造,铜与玻璃的结合力 15N/cm 以上,解决了高密度玻璃基板制造的关键问题。本文将介绍玻璃基板面临的挑战及产品应用情况。

演讲大纲:

1. 玻璃作为下一代集成基板的优势
2. 当前的主要挑战及机遇
3. 解决方案及研究进展
4. 产品应用

适合对象:

在大学和企业的研究人员

演讲人简介:

广东工业大学特聘教授,博士生导师,国家海外高层次人才。同时,是广东佛智芯微电子技术研究公司的创始人和董事长。1983 年和 1985 年分别在天津大学化学工程系获得学士和硕士学位,1991 年在英国埃塞克斯大学(ESSEX)获得化学博士学位。曾主持国家半导体攻关工程、02 专项、863 专项等多项科技项目,在微电子先进封装技术和高密度封装基板的研发和生产方面有 30 多年的经验。在 2016 年加入广东工业大学之前,在新加坡国立大学、新加坡微电子研究所、香港金柏科技和安捷利工作多年。1993 年荣获新加坡李光耀顶尖研究奖。截至 2024 年,累计获得国内外授权专利 120 余项,在国内外著名期刊发表论文 160 余篇。